

ZVEI Empfehlung Designrule Micro-Vias

(Umsetzung erfolgt in der Verantwortung des Anwenders)

| Beschreibung | Standard | | High End |
|--|---|---------------------------------|---|
| Basiskupfer | 9 μm | | 9 μm |
| Endkupferdicke ($i-h$) | 34 μm (+15 $\mu\text{m}/$ -5 μm) | | 34 μm (+15 $\mu\text{m}/$ -5 μm) |
| Restring (Micro-Vias) | > 150 μm | | > 100 μm |
| Dicke Kupferhülse (nicht gefüllt) (e) | IPC Klasse 2 > 15 μm | IPC Klasse 3 > 20 μm | > 20 μm für PTFE |
| Füllfaktor (Verhältnis h/i bei gefüllten Vias) | 60 % - 90 % | | |

Mögliche Varianten

| Bohrdurchmesser f [μm] | Bohrtiefe h [μm] | Prepreg | Aspect-Ratio (max. 0,85:1) | Enddurchmesser ($f-2e$) [μm] |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------|---|
| 100 | 63 | 1 x 1080 | 0,63:1 | 50 - 70 |
| 140 | 100 | 2 x 106 | 0,71:1 | 90 - 110 |
| 170 | 100 | 2 x 106 | 0,59:1 | 120 - 140 |

